

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-011

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☒其他
参与单位名称	线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者； 国寿安保、汇添富、金鹰基金、中信保诚、长城基金、中邮证券、华创证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、阳光保险、Point 72、信达澳亚、前海开源、华宝基金、巨杉（上海）、西部利得、国金证券、中信建投证券、泉果基金、国联安、平安基金、华安基金、汇丰晋信、开源证券、海富通、光大证券、广发证券、圆信永丰、华泰保兴、诺德基金、平安养老、银河基金、上海中兰、上海非马投资、鑫元基金、新华基金、中国人寿养老、建信理财、南方基金、创金合信、上海润义投资、度势投资、东吴基金、泰信基金、华富基金、鹏华基金、浦银安盛、交银施罗德、长安基金、天风证券、华宝兴业、韩国投资信托运用、国药金投、富安达、工银安盛、上海德汇、华夏理财、国投瑞银、上海黑翼、五矿资本、长城财富保险、东北证券、昆仑信托、中欧基金、中钢投资、上海乘是资管、国联民生、上海胜帮、兴银基金、银华基金、太平养老、兴业银行、万兆慧谷、国寿养老、东方富海、人保资产、东兴证券、合众资产、广金投资、源乘投资、中新融创、华夏财富创新、美阳投资、浙商银行、金建投资、泾溪投资、高腾国际、红杉资本、象與行投资、金之灝、亘曦基金、冠达菁华私募、方物基金、禹田

	资本、川流资本、中略投资、泰牛基金、晓甬投资、唐臣投资、嘉实基金、中银基金、诺安基金、融通基金、富国基金、浦银安盛、安信基金、标朴投资、东方自营、博道基金、东方红
时间	2026 年 8 月 26 日-2026 年 9 月 10 日
地点	公司和上海、线上
上市公司 接待人员姓名	董事长：张兵 首席执行官兼首席技术官：向文胜 总经理：陈小华 独立董事：李挺 副总经理、董事会秘书：李瑞媛 财务总监：吕敏 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司管理层介绍 2026 年半年度经营情况 2026 年上半年，公司继续坚持稳健经营的战略目标，受益于半导体行业整体高景气增长及材料国产替代进程加速，实现营业收入 3.46 亿元，同比增长 23.64%。公司始终聚焦电镀与光刻两大半导体核心工艺环节的高端电子化学品，业务加速向先进制程、先进技术领域的高附加值材料延伸，产品结构持续优化，盈利能力显著提升。上半年扣非归母净利润同比增长 41.66%，扣除股份支付影响后的扣非归母净利润同比增长 92.52%。 业务方面，将当前公司产品布局概括为“2+3”。首先是公司中短期业绩增长的两大基本盘：其一是公司的“大马士革电镀产品”：大马士革电镀铜添加剂覆盖 7 - 55nm 制程节点，尤其在 7-28nm 节点，可确保铜互连具有优异的填充能力与低缺陷；而针对更先进节点对互连阻抗和可靠性的更高要求，公司钴制程电镀液具备优异的电迁移耐受性与界面稳定性。从市场格局来看，国内结构性分化明显，先进逻辑制程和存储制程，电镀液等湿电子化学品存在巨大的市场增量和国产替代机遇，公司作为国内极少数具备量产经验的材料企业，正抓住机会将产品导入晶圆制造客户。

其二是公司的先进封装光刻胶产品，随着摩尔定律逐步逼近物理极限，AI 芯片、HBM（高带宽存储）、CPO（数据中心光互联）等市场持续快速扩张，2.5D/3D IC、Chiplet、Fan-out、CoWoS 等先进封装成为延续芯片性能提升的重要路径，催生独立于前道晶圆制造的光刻胶需求体系。与前道薄型光刻胶追求超高分辨率不同，先进封装光刻胶更加注重厚膜均匀涂布、低应力、高低温循环可靠性以及与各类介电基板的适配性；永久绝缘 PSPI、厚膜负性光刻胶、RDL 工艺光刻胶，封装 KrF/ArF 光刻胶构成多层次产品矩阵，是当前技术迭代重点。公司在近十年前开始布局先进封装光刻胶及 PSPI 等感光产品，现在已经形成覆盖 Bumping、RDL、TSV、fine pitch RDL、 μ Bumping、 μ Pad、Mega Bumping 等先进封装核心工艺环节的产品矩阵，正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。

半导体材料处于整个电子产业的最上游，具有技术壁垒高、研发投入大、认证周期长、突破后客户就具有极强粘性的特点，光刻胶及大马士革系列产品的商业化突破，印证了公司具备体系化生产及推动产业落地的能力，因此，在现有业务的支撑下，公司也继续增强研发投入力度，布局下一代广阔增量市场，包括配套 TSV、TGV 及高端载板工艺的电子材料。上半年公司研发费用率维持高位且持续增长，占营业收入比重 13.15%，同比增长 49.55%；研发人员占比提升至 43.32%，同比增长 30.43%，为公司中长期产品升级与市场竞争壁垒构建奠定坚实基础。

经营策略清晰且执行力明确是公司的核心竞争力，公司在产品和研发的积极布局之外，也在公司经营的其他方面，做出了很多更主动的管控和优化，包括境内外制造能力的系统化布局、KPI 考核及激励机制的精细化设计、支持部门对业务及研发的敏捷响应与灵活配合等。

二、问答交流环节

以往机构调研中重复问答，本次活动披露文件中未做介绍。

问题一：据集邦咨询 5 月 19 日发布博文，基于德国设备商 SCHMID 透露信息，台积电正推进面板级 CoPos 封装，重点规格为 310×310 毫米，并在同尺寸上评估玻璃材料整合。请问：公司现有产品如 TGV，负性光刻胶和低温 PSPI 等，是否适配台积电、英特尔、三星等公司正在推进的 CoPos

封装呢？感谢！

答：公司的 TGV 镀铜添加剂目前正配合头部玻璃基板客户测试，公司开发的负性光刻胶可应用于玻璃基封装场景，并且已经获得头部客户量产订单，公司低温 PSPI 已处于客户端小量产阶段，可适配先进封装对应工艺环节的需求。公司会持续关注先进封装领域的技术及市场发展趋势，依托自身在先进封装领域的光刻、电镀产品布局，积极推进相关技术和产品开发，推进与头部客户的合作拓展，抓住行业发展机会提升公司产品市占率。

问题二：祝贺新一届董事会、高管 8 月 12 日当选受聘。公司史无前例新设首席执行官、首席技术官，想了解设立这些岗位的考量，为何选择在当下设立？谢谢！

答：首先感谢您对公司本次换届和治理架构优化的关注。公司在新一届董事会、高管团队完成当选受聘的节点，首次设立首席执行官、首席技术官两个核心岗位，是基于公司长期发展战略、结合当前产业环境做出的审慎决策。首席执行官将专门统筹公司核心业务板块，从资源调度、团队协同到商业化目标达成全流程牵头负责，打通从董事会战略部署到一线业务执行的闭环，避免战略落地过程中出现权责分散、推进滞后的问题。首席技术官岗位，将统一牵头公司核心技术路线规划、前沿工艺研发、产学研资源整合和知识产权体系搭建，集中资源攻坚半导体材料领域的“卡脖子”环节。

问题三：张董事长，您好。作为一名艾森股份的长期投资者，公司一直给我的感觉是小而美。但是，公司的成长增速始终没有体现高成长的弹性，营收增速增幅都偏小。公司一直注重内生性发展，自己研发自己投资扩产，但是投资扩产的周期偏慢，会不会容易错失发展良机？对此，建议有二，一是希望公司管理层积极考虑通过上下游并购，做大营收，强化产业链协同。二是希望公司进一步重视市值管理，进一步加强投资者交流互动，提升市场信心。谢谢。

答：您好，已收到您对公司的建议，感谢您对公司的关注。关于您提出的上下游并购相关建议，公司会结合自身发展实际情况统筹考量，后续若有相关规划，公司会严格按照信息披露要求及时公告。在市值管

理方面，公司注重产品研发和业务技术的突破，持续高研发投入，从而实现业绩的稳步增长。公司采取现金分红、资本公积转增股本、管理层增持公司股份、回购公司股份、实施员工股权激励，用于维护公司价值及股东权益，推动公司内在价值提升。另外公司建立了包括信息披露、e互动、业绩说明会、路演、反路演、组织中小投资者调研等多渠道沟通体系，持续加强与广大投资者的沟通交流，有效传递公司价值。

问题四：1. 先进封装对光刻胶及配套试剂的需求从线性增长转向超线性扩张。公司先前提到 2028 年华东基地投产前，现有 16000 吨产能可以满足市场需求，目前仍维持这样的判断吗？2. 今年上半年，晶圆/封测/存储等需求端的扩产进度及投资都明显加快，华东基地中报中资金利用率并不高，项目是否按计划建设？

答：公司会结合下游市场需求动态调整生产及产能安排，依托现有昆山基地、南通基地、东南亚基地的产能基础，灵活适配市场需求，保障核心客户的稳定供应。此外，为应对过渡期可能的供应压力，公司也通过与中试基地的合作模式，以灵活补充阶段性产能需求，确保客户交付稳定。公司目前正在按计划推进新华东制造基地项目的相关前期工作，华东制造基地一期预计 2028 年投产，二期将在一期竣工后 6 个月内启动、预计 2030 年投产，整体项目预计于 2035 年全面达产。项目资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司将统一调配资金，遵循统筹规划、分步实施的原则安排投资建设进度，持续按计划推进项目相关的行政报批、前期准备等工作，确保项目按既定节奏落地。

问题五：介绍下马来西亚槟城工厂建设情况，下半年是否顺利投产，主要产品及产能是多少？

答：公司东南亚制造中心目前按计划在建设中，主要产品为湿电子化学品，公司亦在积极布局光刻胶产品的跨境销售，项目建成后主要服务在东南亚设厂的国际头部半导体客户，实现“本地化生产、全球化供应”，精准对接全球供应链的核心需求。

问题六：晶圆/封测厂上半年产能利用率基本拉满，市场需求是否已经饱和？公司觉得下半年及明年的营收增量主要会来自哪里？

答：从行业情况来看，当前国内半导体行业呈现结构性分化特征，8

英寸晶圆、40nm 以上成熟制程产能持续释放，但 14nm 及以下先进逻辑制程、高端 HBM 存储、先进封装以及半导体核心材料等关键领域，依旧存在显著供需缺口。AI 芯片、高带宽存储、Chiplet 等先进封装领域需求持续快速扩张，先进封装光刻胶及配套湿电子化学品需求已经呈现超线性增长的态势，高端半导体材料国产替代仍有充足的市场空间。从公司层面来看，下半年及未来营收增量主要来源于：其一，公司先进制程电镀液业务正处于从“单产品技术突破”向“规模化量产落地”的关键阶段，晶圆制造领域湿电子化学品业务将持续放量，目前公司 28nm 大马士革镀铜添加剂和超高纯硫酸钴基液已在头部客户实现量产，后续随着产能释放将逐步贡献增量。其二，受益于下游先进封装形式持续迭代升级，叠加国产替代进程全面加速，公司高端光刻胶产品已完成头部客户全流程验证并实现批量落地，先进封装领域光刻胶及配套产品业务已经实现规模化稳定供货，AI 驱动 HBM 等先进封装需求爆发带来的光刻胶超线性增长，将持续为公司营收增长提供动力。

问题七：请问咱们公司对十年营收增长十倍的宏愿还有信心吗？

答：公司对公司业务的发展充满坚定信心，半导体材料国产替代的长期产业红利持续释放，公司“电镀+光刻”双轮驱动的产品壁垒已经筑牢，先进制程电镀液和先进封装光刻胶已完成深度卡位。公司在半导体材料赛道已经深耕十余年，核心团队战略定力充足，沿着既定目标稳步推进，目标落地过程中会遇到行业周期波动等挑战，但公司会逐年扎实推进经营目标，稳步向十年十倍的战略愿景迈进。

问题八：公司上半年营收净利增长的主要驱动因素是什么？

答：2026 年上半年公司实现营业收入 3.46 亿元，同比增长 23.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 41.66%，增长的主要驱动因素为：半导体行业整体维持高景气增长态势，叠加晶圆及先进封装材料国产替代提速，公司锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，不仅在半导体封装领域实现对国外供应商的规模化替代，稳固国内市场的核心主力供应商地位，在高端先进封装和晶圆领域的市场开拓也取得成效。公司先进制程电镀液产品持续放量增长，先进封装光刻胶亦在多家客户处实现规模化导入。公司业务正加速向先进制

程、先进技术领域的高附加值材料延伸，产品结构持续优化带动综合毛利率稳步提升，推动公司营收与净利实现稳健增长。

问题九：南通艾森“年产 12000 吨半导体专用材料项目”当前建设进度、产能利用率，与下游晶圆厂扩产节奏是否匹配？

答：“年产 12000 吨半导体专用材料项目”为公司 IPO 募投项目，也是公司南通工厂，已全面建成投产，为公司当前核心产能载体和运营主体，当前处于产能利用率爬坡阶段，可覆盖 2028 年华东制造基地一期投产前的市场需求，项目布局的先进封装光刻胶、大马士革电镀液等核心产品，适配下游晶圆厂、封测厂的扩产节奏，已批量导入多家头部客户，依托区位优势大幅缩短了本地化交付周期，实现了与下游产业升级需求的高度协同。

问题十：公司客户名单亮眼，主要产品基本都跨过了认证门槛期，但目前份额普遍不高，下一步在提升国产替代份额上会做哪些努力？

答：公司已经在先进封装光刻胶、晶圆制造电镀液等领域实现从“0 到 1”的技术突破，正处于向规模化国产替代迈进的关键阶段。首先，公司将紧跟行业技术迭代趋势，始终以客户需求为导向深耕产品研发，依托自身技术积累与供应链优势，在优化现有产品性能稳定性与一致性的同时，持续开发适配先进制程、先进封装需求的新产品，目前公司已与多家国内头部晶圆、先进封装客户建立联合开发机制，同步参与客户前沿制程研发，已有多款定制化产品通过认证并实现进口替代；其次，公司依托再融资募投项目推进高端产品产能建设，项目精准聚焦先进封装光刻胶、PSPI、KrF 光刻胶、高端湿电子化学品等核心品类，项目建成后将实现高端产品的规模化、高质量产，进一步匹配客户大规模导入国产材料的产能需求，支撑公司市场份额提升。最后，持续深度绑定下游头部客户，紧抓国产替代进程加速的行业机遇，依托现有“电镀+光刻”双工艺的协同优势，深化与合作。

问题十一：请问公司如何看待半导体材料的对日替代，我们公司哪些产品在向这一方向推进？

答：当前国内半导体产业链实现自主可控的意愿强烈，公司作为半导体材料领域的核心供应商，目前围绕两大核心产品和三大拓展领域，

	全面推进国产替代进度。公司先进制程电镀液及先进封装光刻胶实现“0到1”突破，迈入国产替代新阶段，持续高强度研发投入，布局 TSV、TGV 及高端载板工艺配套电子材料，PSPI 材料与核心产业链客户合作全面深化，助力产业链客户工艺升级。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 11 日